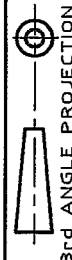


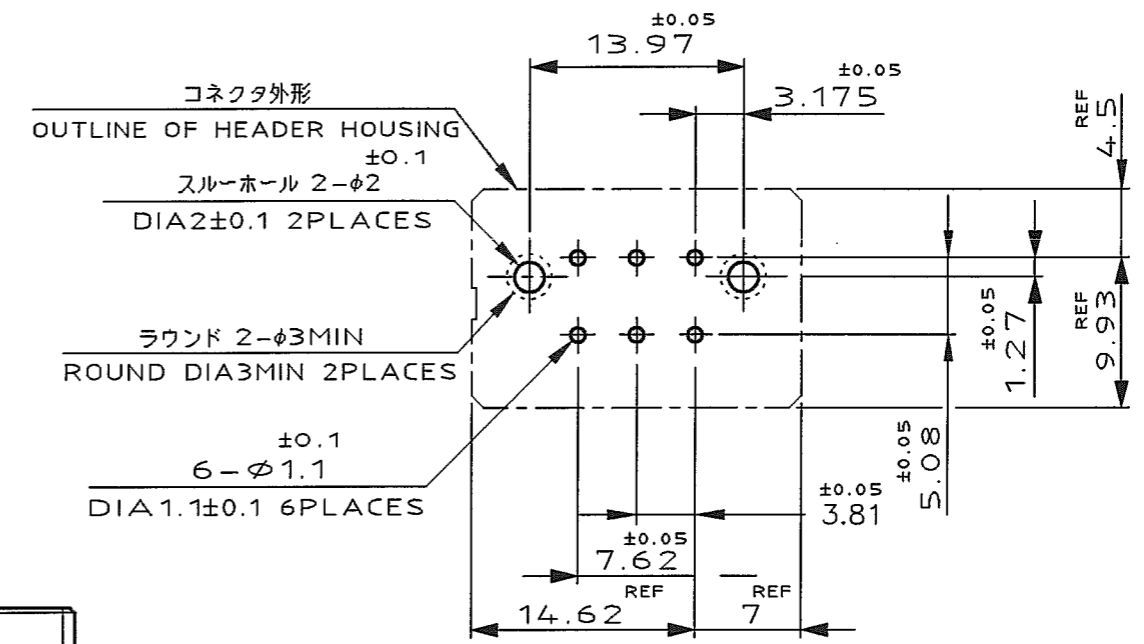
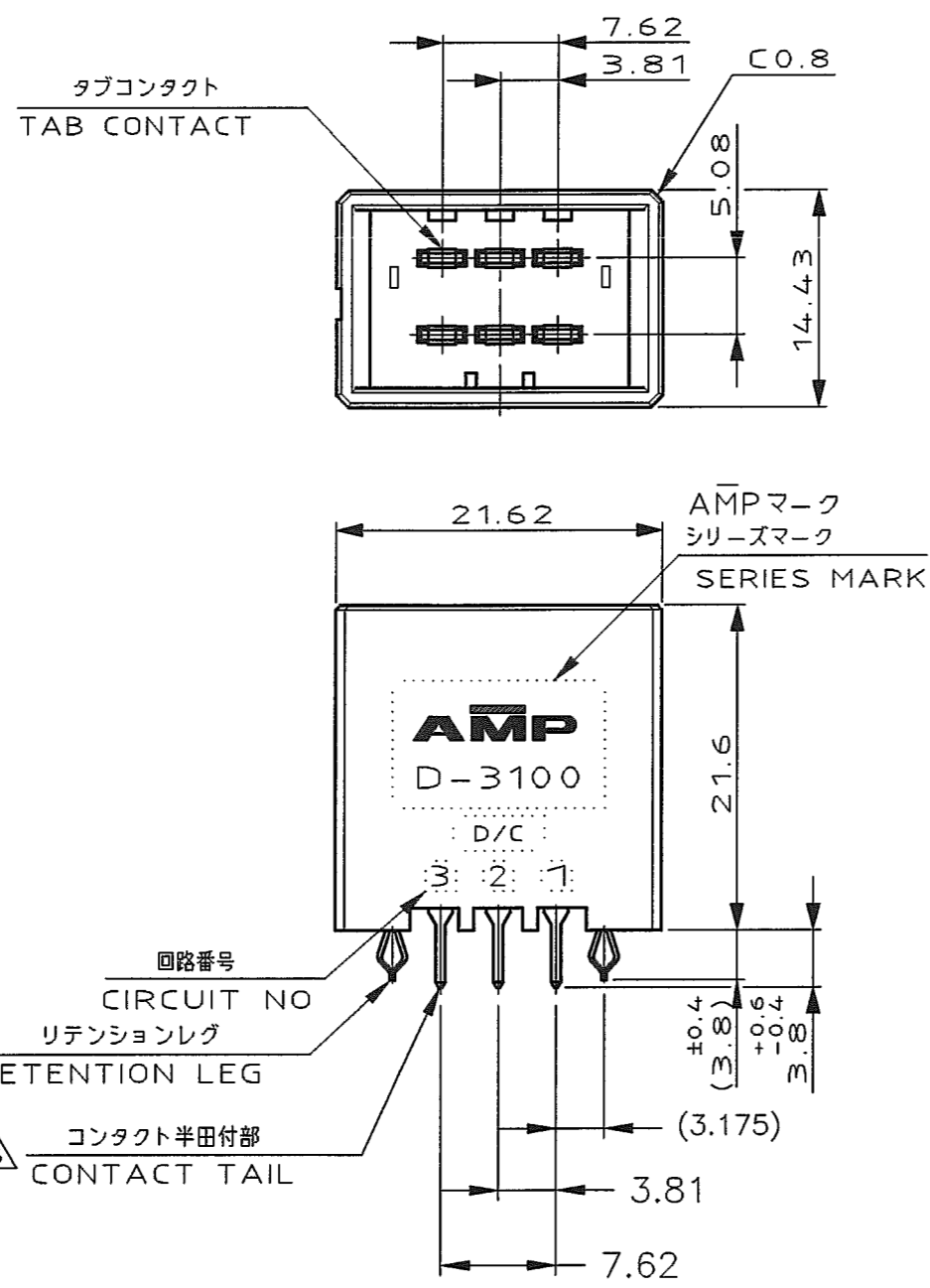
NUMBER 178323



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚: 1.6 ± 0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- ~~FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
+ ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	178323-5
△6	△3	178323-3
△6	△2	178323-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA	NAME	
mm (AWG - )		mmφ	DOUBLE ROW (D-3100)	
MATERIAL		FINISH	DYNAMIC CONN. 6POS. VERTICAL HDR. ASS'Y	
SEE NOTE		SEE NOTE		
注記参照		注記参照		
DR. 15 FEB 91		DE. 15 FEB 91	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
N. Matsubara		N. Matsubara	10mm以下: ±0.3	
CHK. 21 MAY '91		APP. 21-MAY-'91	10mm以下: ±0.4	
T. Obata		S. MANABE	30mm以下: ±0.5	
			角 度: ±3'	
			SIZE	LOC
			A3	J
			NUMBER	
			C-178323	
			SCALE	REV.
			2-1	D1
			SHEET	
			1 OF 1	

